

华虹半导体有限公司

独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联（连）交易相关事项的事前认可意见

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会将于 2025 年 12 月 31 日作出董事会决议，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们认真审阅了公司提供的有关资料，现就本次董事会会议涉及的相关事项，基于独立判断发表事前认可意见如下：

公司拟通过发行股份的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微 97.4988% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联（连）交易。我们已认真审阅董事会拟审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

1、本次交易方案、公司拟签订的相关交易协议符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、具备可操作性。

2、本次交易有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，本次交易将进一步提高公司资产质量，提升市场竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

综上，我们一致同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

（本页无正文，为《华虹半导体有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项的事前认可意见》之签署页）

张祖同

王桂壘，太平紳士

封松林